

<<赴美留学申请材料剖析>>

图书基本信息

书名：<<赴美留学申请材料剖析>>

13位ISBN编号：9787801443533

10位ISBN编号：7801443535

出版时间：2000-3-1

出版时间：宇航出版社

作者：李树,王尔

页数：123

字数：198000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<赴美留学申请材料剖析>>

内容概要

本书详尽地介绍赴美留学申请过程中各类申请材料的写作要点、写作方法和表述方式，并给出一系列经典实例。

申请者通过阅读此书，可以很快地掌握如何准备有强烈感染力的申请材料，如何出奇制胜的方法。

本书对欲申请赴美留学的人士具有极大的指导意义和参考价值。

<<赴美留学申请材料剖析>>

书籍目录

序 1 个人计划 2 向学校索取申请材料 3 个人简历 (Resume or Curriculum Vitae) 4 读书计划 (Personal Statement or Statement of Purpose) 5 推荐信 (Letters of Reference or Letters of Recommendation) 6 中英文官方成绩单及学位、学历证明 7 与ETS联系寄送官方成绩 8 申请费 (Application Fee) 9 与学校教授联系 10 其他函形式 11 关于经济担保 (Financial Sponsorship) 12 签证申请 (Visa Application) 附录 附录1 美国大学排行榜 附录2 美国主要大学图书馆藏书数目一览表 附录3 美国名校介绍参考文献

<<赴美留学申请材料剖析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>